



Press Information

Messen

TDK präsentiert auf der PCIM unter dem Motto „The power in your design“ die neuesten Lösungen für Industrie, Automotive und KI-Rechenzentren

- Unter dem Motto „The power in your design“ präsentiert TDK vom 9. bis 11. Juni 2026 auf dem Gelände der NürnbergMesse Technologien, die leistungstärkere und energieeffizientere Systeme ermöglichen
- Am Stand 350 in Halle 9 haben Besucher die Möglichkeit, die neuesten Lösungen für passive Bauelemente und Sensoren für die Branchen Wind- und Solarenergie, Antriebe in der Industrie und im Schienenverkehr, Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge, Elektromobilität und KI-Rechenzentren kennenzulernen

18. Mai 2026

Die TDK Corporation präsentiert auf der diesjährigen PCIM an Stand 350 in Halle 9 ihre neuesten Entwicklungen in den Bereichen passive Bauelemente und Sensorlösungen. Die Fachmesse findet vom 9. bis 11. Juni 2026 auf dem Gelände der NürnbergMesse statt. Das Messemotto von TDK lautet „The power in your design“. Dies hebt hervor, dass das Unternehmen es seinen Partnern und Kunden ermöglicht, leistungstärkere Systeme für die Bereiche Industrie, Automotive und KI-Rechenzentren zu entwickeln.

Messe-Highlights

The power in industrial and green energy

- TDK zeigt einen Inverter-Power-Stack vom Ingenieurbüro Hoffmann, der mit 3-kV-ModCap-Kondensatoren von TDK im DC-Link sowie 3,3-kV-SiC-MOSFETs ausgerüstet ist. Dieses System ist in erster Linie für große Energiespeichersysteme und Schwerlastfahrzeuge konzipiert.
- Ein weiteres Highlight ist ein 2L-B6I-Inverter, der mit Folien-Kondensatoren der Serie B25697* von TDK im DC-Link sowie 2,3-kV-CoolSiC™-MOSFETs von Infineon in deren XHP™-2-Power-Modulen ausgestattet ist. Dieses Referenzdesign zeigt, wie TDK seine Kunden bei der Entwicklung von leistungsstarken Lösungen für Energiespeichersysteme, Wind- und Solarwechselrichter, Wasserstoffsysteme, DC-Mikronetze und Schnellladegeräte unterstützt.
- Um zu demonstrieren, wie TDK auf schnell wandelnde Marktanforderungen reagiert, können Besucher auch ein Dispenser Blade des EcoG Powerblock für das Laden von Elektrofahrzeugen sehen. Jedes Blade verfügt über ein 4-in-1-HVC-Modul statt vier diskreter Hochspannungsschütze, was Montage und Wartung vereinfacht.
- Ebenfalls zu sehen ist ein 280-kW-Referenzdesign von Infineon für einen Antriebsumrichter für Nutz-, Bau- und Landwirtschaftsfahrzeuge (eCAV), bei dem TDKs xEVCap im DC-Link zum Einsatz kommt.
- Besucher können außerdem mehr darüber erfahren, wie TDK mit seinen Temperatur- und Drucksensoren ein effizientes und zuverlässiges Wärmemanagement unterstützt. Diese Sensoren lassen sich direkt in Kühlkreisläufe integrieren und zeichnen sich durch kurze Reaktionszeiten, robuste Signalstabilität und einfache Integration aus.

The power in automotive

- Anhand eines modernen Traktionsmotors präsentiert TDK seine Temperatur- und Drucksensoren sowie integrierte Motorsteuerungen und Hall- und TMR-basierte Magnetfeldsensoren – einschließlich Stromsensoren –, die eine breite Palette von E-Motor-Funktionen wie Rotorpositionserfassung, Resolver-Ersatz und Strommessung unterstützen. Die neu vorgestellten TMR-TAS-Magnetfeldsensoren erfassen analoge Signale verzögerungsfrei und mit hoher Bandbreite auf kleinstem Raum und bieten damit eine leistungsstarke und kostengünstige Alternative zu induktiven und resolverbasierten Lösungen.
- Gemeinsam mit Infineon und Shin-Etsu Silicones Europe stellt TDK einen Demonstrator für einen 300-kW-Traktionsumrichter vor, der vier xEVCaps als DC-Link-Kondensatoren sowie den CarXield als EMV-Filter enthält. Infineon steuerte die Umrichter-Plattform auf Basis von EconoDUAL™ 3-Leistungsmodulen bei, Shin-Etsu die Klebstoffe und Gap-Filler für die mechanische und thermische Anbindung.
- Der neue Demonstrator der smarten AlN-Mehrschichtsubstrate liefert Besuchern einen genauen Einblick in diese moderne Wärmemanagement-Technologie. Zu den wichtigsten Eigenschaften von AlN (Aluminiumnitrid) zählen seine im Vergleich zu anderen keramischen Substratmaterialien hohe Wärmeleitfähigkeit sowie sein thermischer Ausdehnungskoeffizient (CTE), der denen gängiger Halbleitermaterialien wie Silizium und Siliziumkarbid (SiC) sehr nahekommt.
- Am Stand zu sehen ist auch die „Tiny Power Box 2“. Dieses 11-kW-Bordladegerät (OBC) von Silicon Austria Labs ist mit dutzenden von CeraLink-Kondensatoren von TDK ausgestattet. Dieses Ladegerät unterstützt sowohl den dreiphasigen als auch den einphasigen Betrieb und verfügt über einen DC-DC-Wandler mit einem isolierten 14-V-Ausgang.
- Ein weiteres Highlight im Automotive-Bereich ist das kostenoptimierte Referenzdesign „IDEA“ für Traktionsumrichter von Infineon. Es kombiniert den xEVCap im DC-Link und die InsuGate-Transformatoren von TDK zur Ansteuerung der Transistoren sowie die diskreten IDPAK-Produkte von Infineon.

The power in AI data centers

Der Leitgedanke „From grid to core“ bildet die Grundlage für TDKs Strategie, die gesamte Energieinfrastruktur von KI-Rechenzentren mit passiven Bauelementen, Sensorlösungen und DC/DC-Wandlern zu bedienen. Neben der Kernanwendung, der Power Supply Unit (PSU), boomen derzeit unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV) und Batterie-Energiespeichersysteme (BESS) für KI-Anwendungen. Gleiches gilt für die Point-of-Load-Umwandlung neben dem Prozessor. Für all diese Teilanwendungen verfügt TDK über ein umfassendes Lösungsportfolio. Künftig wird die Solid-State-Transformator-Technologie (SST) eine wichtige Rolle spielen, und TDK ist darauf vorbereitet.

- Am Stand können Messebesucher erfahren, wie die ultrakompakten Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren von TDK dafür sorgen, dass die PSU-Referenzdesigns von Infineon AI-Servern 8 kW oder 12 kW bei minimaler Baugröße liefern können.
- TDK wird außerdem aufzeigen, wie sich der ModCap, eine modulare, standardisierte Lösung für DC-Link-Kondensatoren, gut in das modulare Konzept der meisten SSTs einfügt.
- Ein weiteres Highlight sind Hochspannungsschütze wie der HVC29, die für Sicherheit in 800-V-DC-Verteilerumgebungen sorgen.
- Ebenfalls zu sehen sind μ POL-Wandler von TDK. Mit dieser modularen Point-of-Load-Lösung lassen sich FPGAs, SoCs oder ASICs mit bis zu 200 A versorgen, und sie eignet sich für Vertical-Power-Delivery-Architekturen in KI-Systemen.

The power in EMC testing

TDK steht kurz davor, ein deutlich größeres EMV-Labor in Regensburg fertigzustellen. Der neue akkreditierte Komplex wird eine Fläche von fast 1.700 Quadratmetern umfassen, davon 1.100 Quadratmeter für Labore und Messplätze. Außerdem wird er einen Showroom und einen großen Besucherbereich mit Tagungsräumen beherbergen. Auf der PCIM können Besucher mehr über das neue Labor und die EMV-Dienstleistungen von TDK erfahren.

Am Stand können Messebesucher auch die von TDK selbst gefertigten Absorber sehen, darunter Platten und Pyramiden sowie Sinusfilter für bis zu 720 A und 2-Leiter-Filter für Anwendungen in der Leistungselektronik mit bis zu 1500 V/1600 A.

The power in expertise

Experten von TDK werden umfassende Einblicke in die wichtigsten Technologien für E-Mobilität, Energiespeicherung, KI-Rechenzentren und Solid-State-Transformatoren geben. Die Vorträge zeigen, wie die Expertise von TDK im Bereich Bauelemente und Systeme den Kunden hilft, Herausforderungen beim Design zu meistern und die Entwicklung zukunftsfähiger Leistungselektronik voranzutreiben.

- David Olalla, [xEVCap Next Level: Capacitor Bank and Thermo-Mechanical Evaluation of a Powertrain Inverter](#), 10. Juni, 16:15 Uhr, E-Mobility & Energy Storage Stage, Halle 6, Stand 220
- Anirban Roy, [Technologies Powering the Shift to Solid-State Transformers: How TDK Technologies Enable the Transition](#), 11. Juni, 10:00 Uhr, AI & Data Centers Stage, Halle 5, Stand 320
- Alberto Espinar, [xEVCap Next Level: Capacitor Bank and Thermo-Mechanical Evaluation of a Powertrain Inverter](#), 11. Juni, 11:15 Uhr, Poster Session, Halle 4A

Über die TDK Corporation

TDK Corporation (TSE:6762) ist ein globales Technologieunternehmen und Innovationsführer in der Elektronikindustrie mit Sitz in Tokio, Japan. Unter dem Motto „In Everything, Better“ verfolgt TDK das Ziel, eine bessere Zukunft in allen Bereichen des Lebens, der Industrie und der Gesellschaft zu verwirklichen. Seit mehr als 90 Jahren prägt TDK technologische Entwicklungen – von den ersten Ferritkernen über Audio- und Videokassetten bis hin zu modernen Bauelementen, Sensoren und Batterien, die das digitale Zeitalter vorantreiben und den Weg in eine nachhaltigere Zukunft ebnen. Vereint durch den TDK Venture Spirit – eine Start-up-Mentalität, die auf Visionen, Mut und gegenseitigem Vertrauen basiert – arbeiten unsere weltweiten Teams an Verbesserungen: für unsere Beschäftigten, Kunden, Partner und die Gesellschaft. Die Technologien von TDK sind in nahezu allen Bereichen des modernen Lebens zu finden: von Industrieanwendungen über Energiesysteme und Elektrofahrzeuge bis hin zu Smartphones und Gaming. Das Portfolio von TDK umfasst modernste passive Bauelemente, Sensoren und Sensorsysteme, Stromversorgungen, Lithium-Ionen- und Festkörperbatterien, Magnetköpfe, KI- und Unternehmenssoftware-Lösungen und vieles mehr – darunter zahlreiche marktführende Produkte. Diese werden unter den Produktmarken TDK, InvenSense, Micronas, Tronics, TDK-Lambda, TDK SensEI und ATL vermarktet. Einen strategischen Schwerpunkt setzt TDK auf Künstliche Intelligenz und nutzt sein globales Netzwerk in den Bereichen Automotive, Informations- und Kommunikationstechnologie sowie Industrierausrüstung für weiteres Wachstum. Im Geschäftsjahr 2026 erzielte TDK einen Gesamtumsatz von 16,6 Milliarden US-Dollar und beschäftigte weltweit rund 107.000 Mitarbeiter.

Den Text dieser Meldung sowie Bilder dazu können Sie unter www.tdk-electronics.tdk.com/de/260518 herunterladen.

Weitere Informationen über den Messeauftritt finden Sie unter www.tdk-electronics.tdk.com/en/3474864/company/tradeshows-events/pcim.

Kontakt für Medien

Kontakt	Telefon	Mail
Ralf HIGGELKE	TDK Electronics AG München, Deutschland	+49 89 54020 1378 ralf.higgelke@tdk.com